



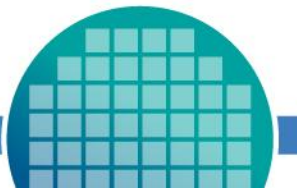
力積電

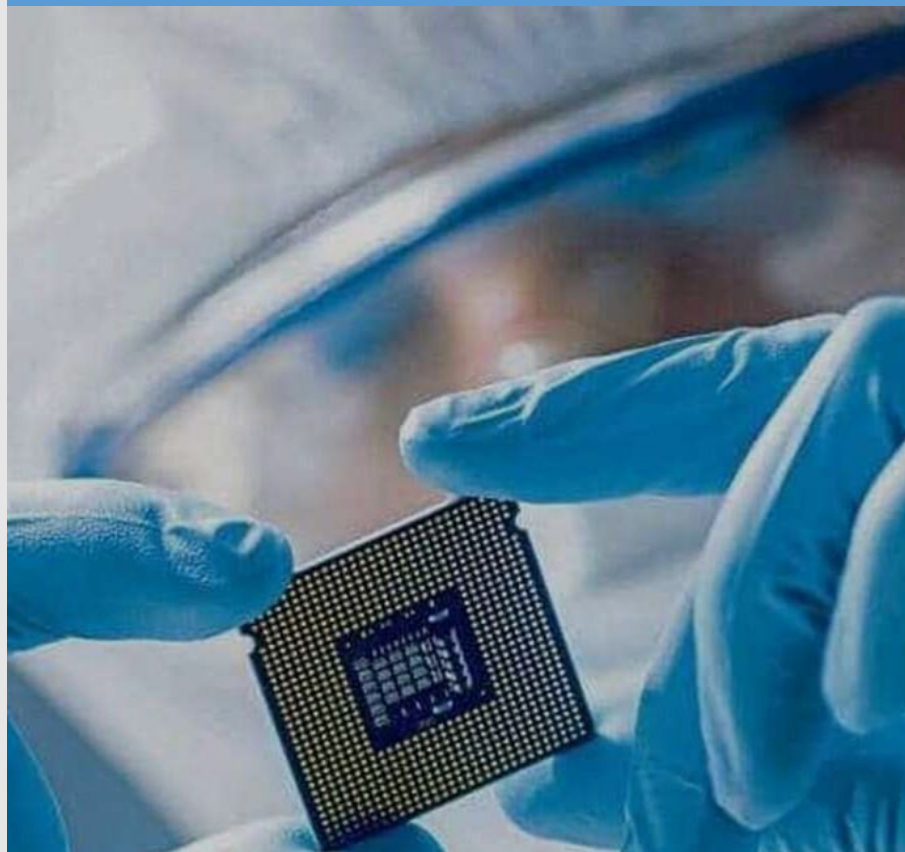
公司簡介



免責聲明

- 本簡報中所提及之預測性資訊包括營運展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。
- 本公司未來實際所可能發生的財務狀況以及經營成果，可能與這些明示或暗示的預測性資訊有所差異。其原因可能來自於各種因素，包括但不限於市場風險、供應鏈、市場需求，以及本公司持續推出高品質產品與服務之能力等因素。
- 本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時再度提醒或更新。





第一部份

公司概況

力積電總覽



多元晶圓代工科技強化 AI 供應鏈



Open Foundry

3D AI • 記憶體 • 邏輯

攜手策略夥伴，驅動AI規模



6

晶圓廠

2 座 8 吋 / 4 座 12 吋



TOP 5

全球半導體產業
ESG 評比⁽¹⁾



163

萬片晶圓

2025 年出貨量
(相當於300mm)



8,300+

員工人數⁽²⁾

88%具有大專或以上學歷



NT\$472億

2025年營收

年度成長 8%

Note:

1) 2024 年 DJSI 排名

2) 截至2025年12月31日



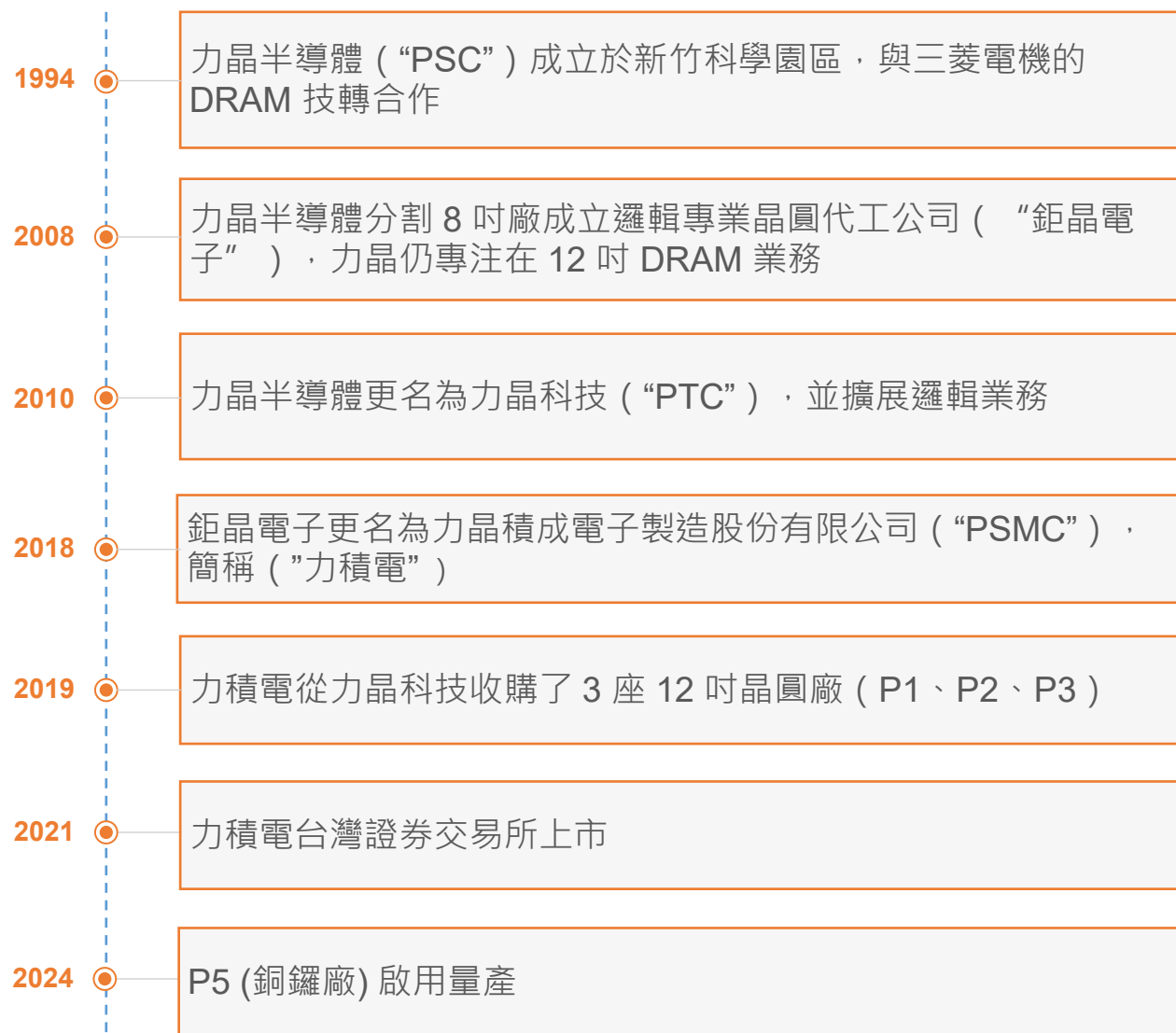
2024 DJSI 排名



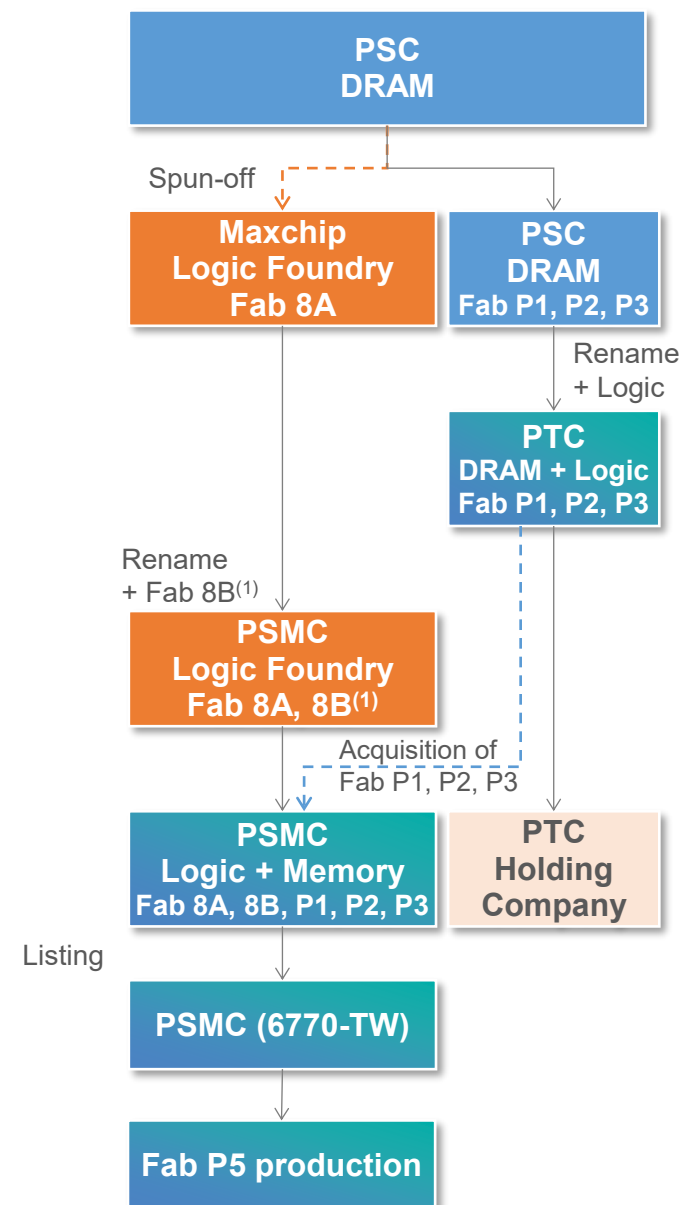
Ranking	Score	Company Name
1	95	United Microelectronics Corporation
2	93	ASE Technology Holding Co., Ltd.
3	88	Vanguard International Semiconductor Corporation
4	86	Taiwan Semiconductor manufacturing Company Limited
5	85	Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.
6	84	Nanya Technology Corporation
7	80	WIN Semiconductors Corp.
8	78	STMicroelectronics N.V.
9	76	Infineon Technologies AG
10	75	Tokyo Electron Limited



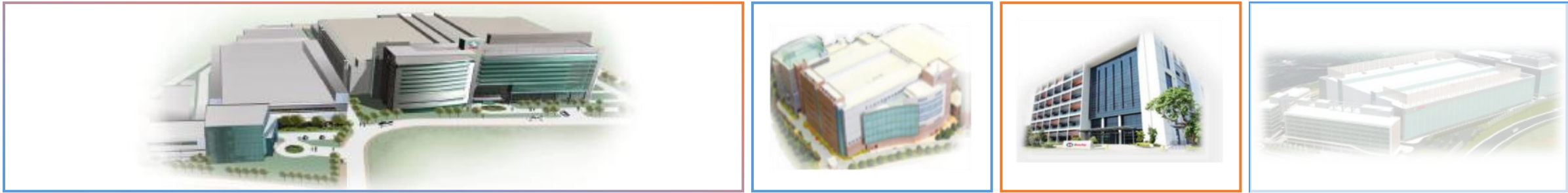
我們的發展沿革



Note:
(1) Purchased 8B in 2017 and started mass production in 2019



我們的晶圓廠



	Fab 8A	Fab P1	Fab P2	Fab P3	Fab 8B	Fab P5
量產 ⁽¹⁾	1996	2002	2005	2007	2019	2024
地點	新竹	新竹	新竹	新竹	竹南	銅鑼
Wafer	8" (200mm)	12" (300mm)	12" (300mm)	12" (300mm)	8" (200mm)	12" (300mm)
產能 ⁽²⁾	75K WPM	73K WPM (P1 + P2)		35K WPM	36K WPM	Phase I: 9/35K WPM Phase II: TBD
技術	350 – 110nm	180 – 24nm	180 – 24nm	30 – 1Xnm	350 – 110nm	55 – 1Xnm
產品	邏輯/分離式元件	邏輯/記憶體	邏輯/記憶體	記憶體	分離式元件	邏輯/3D先進堆疊

Note:
(1) Mass production
(2) In terms of wafer per month in respective wafer size (200mm / 300mm)
(3) PSMC and Micron Technology signed a letter of intent (LOI) on January 16 2026, under which PSMC will sell its Fab P5 to Micron Technology.



我們的業務



專業邏輯和利基型記憶體

多樣化的專業邏輯IC產品

邏輯
60.5%⁽¹⁾


Power IC
Power Discrete
DC/DC | AC/DC | LED Driver
MOSFET | IGBT | GaN


MCU / COMM
MCU | OIS | RF | NFC
RFID | BlueTooth | Wifi


顯示晶片
STN | TFT LCD | OLED
e-paper | e-tag

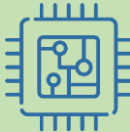

影像感測器
FSI CIS | BSI CIS
a-Si | FoD

價格波動較小的利基型記憶體產品

記憶體
39.5%⁽¹⁾


DRAM
Consumer DRAM
Niche DRAM


Flash
SLC NAND Flash
NOR Flash


Emerging Memory
AIM
Wafer-on-Wafer

終端市場應用



AI 伺服器數據中心



車用電子



消費型電子產品



工業電子



物聯網



白色家電



安全及其他

註：
(1) 截至2024年的營收

對ESG的堅定承諾



永續績效與榮耀

S&P Global

S&P Global 2024 年永續年鑑

成績獲評為**全球半導體產業排名第 5 名**

公司治理評鑑

2024 年度第十一屆公司治理評鑑排名
在上市公司組**前 5%**



TCSA 台灣企業永續獎

榮獲「永續報告書獎」**白金獎**

榮獲「單項績效 - 職場福祉」**領袖獎**：製造業及能源產業」

CDP 評比

水安全、氣候變遷問卷評比

水安全問卷獲得**A** 領導等級，氣候變遷問卷獲得**B** 管理等級



環境

- 實現2024年所有工廠節電1%的目標
- 實現2024年溫室氣體平均年削減率1%的目標
- 實現2024年設置再生能源設施 / 採購綠電比例>8%的目標
- P5廠0.5MW太陽能光電系統設置完成，全廠區累計設置容量達1MW（預估年產生125 萬度的綠電）



社會

- 獲取 RBA VAP (Validated Audit Process) 驗證
- 零強迫勞動
- 100%完成培訓計劃
- 100%員工接受勞工保障權益培訓的完成率
- 所有員工定期接受績效評估



公司治理

- 5名獨立董事，超過半數的董事會成員
- 收集了548份調查問卷，綜合評估對公司價值與經濟、環境、人與人權之影響，鑑別出15項重大主題
- 無倒閉情事
- 所有營運據點無重大違規行為
- 無重大資訊安全事件

擁有豐富產學經驗的董事會成員



張嘉臨

獨立董事



陳俊聖

獨立董事



吳重雨

獨立董事



葉疏

獨立董事



曹世綸

獨立董事



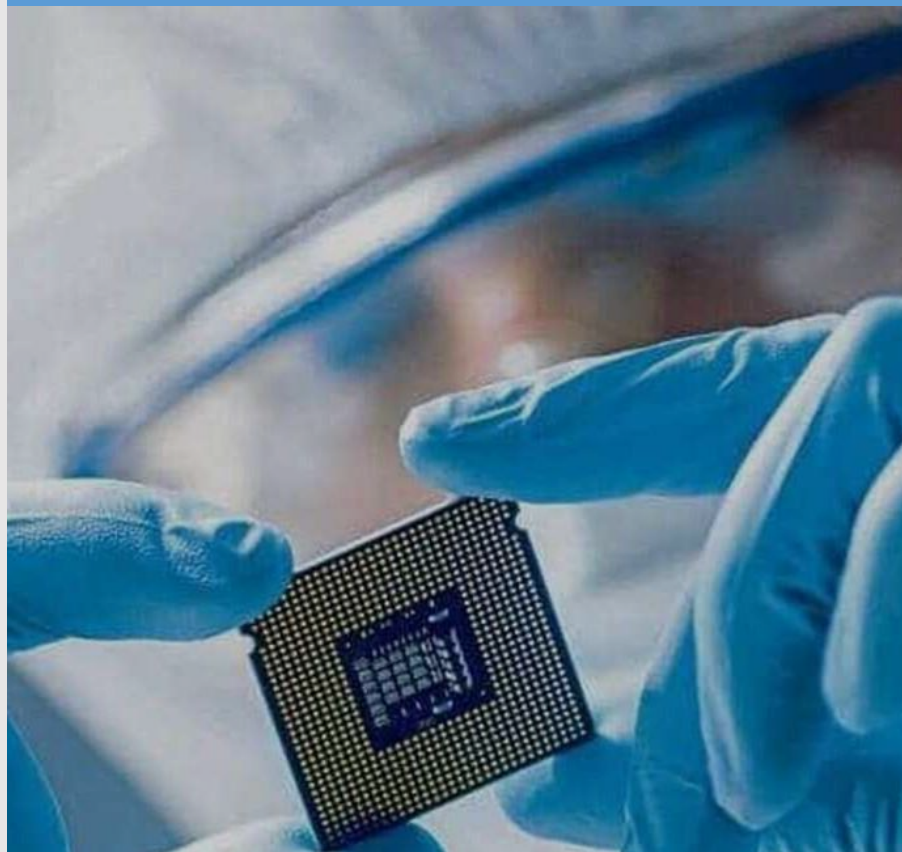
陳文良

董事



資料來源：公司





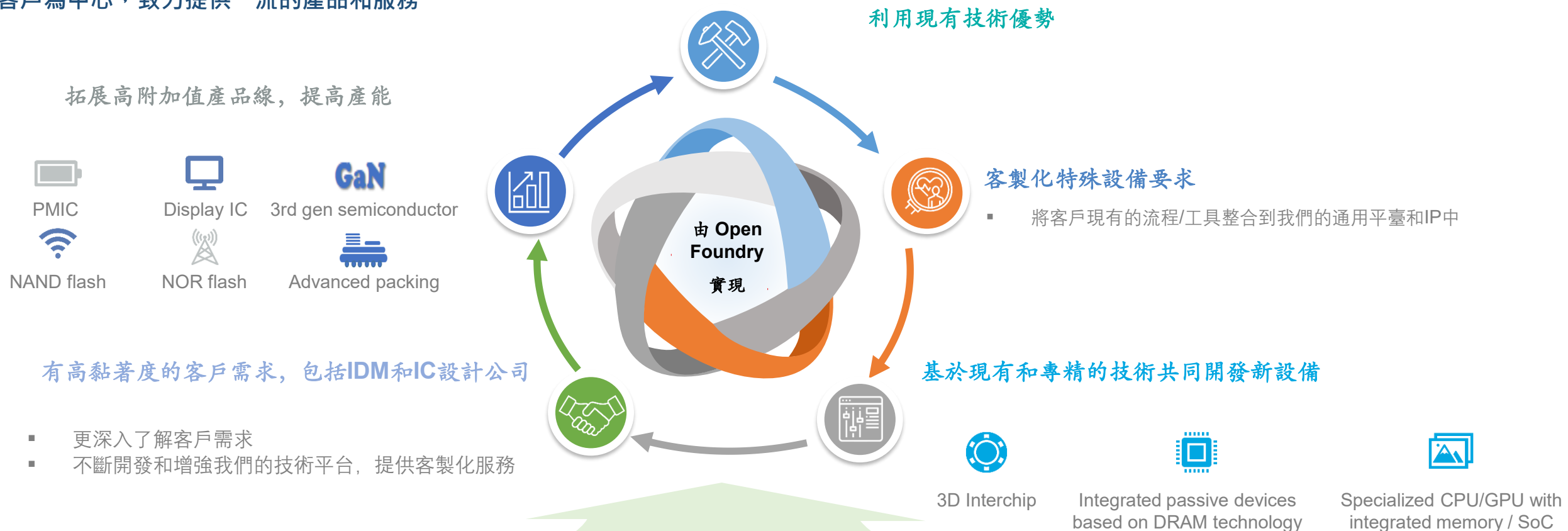
第二部分

投資亮點

Open foundry 模式



以客戶為中心，致力提供一流的產品和服務



我們的製程平台/通用平台



8-inch logic fab

(Focus on production of power discrete, which was dominated by 6-inch fabs)



12-inch logic fab

(Focus on specialty logic using aluminum line, which was more cost efficient than 8-inch fabs)



Memory foundry

(Focus on mid-low density niche products with known-good-die in nature)



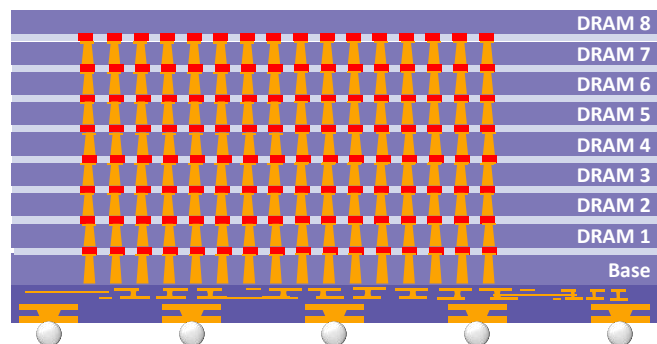
3D AI foundry

(Focus on customized Cu interposer, WoW, CoW foundry)

資料來源：公司

誠信 | 服務 | 品質 | 創新

力積電 3D AI 晶圓代工



4-8 層 DRAM 晶圓堆疊

可支援規格

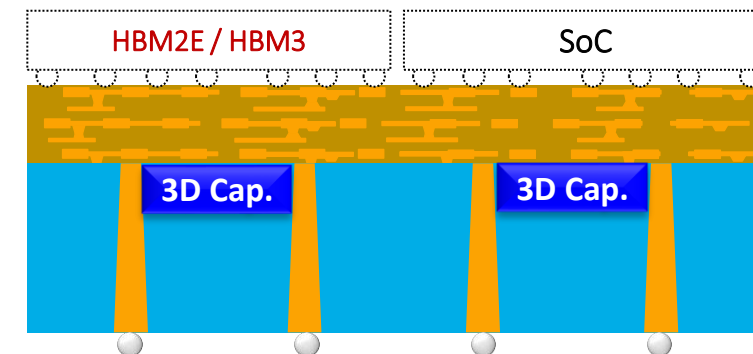
容量：2-8GB

頻寬：1-8TB/s

資料連接通道：> 10K

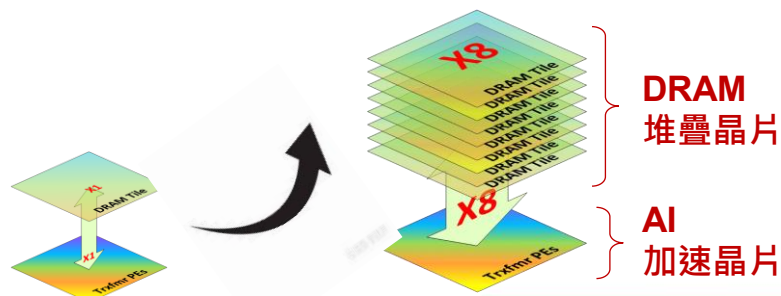
資料移動耗能：< 1pJ/bit

系統製造
(SI, OEM, ODM, CSP)



矽中介層 / 橋接

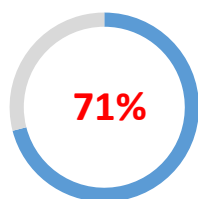
- 3.x 倍滿版光罩大小
- 5-8 層厚銅金屬層
- 嵌入式電容的電容值密度 > 1000 nF/mm²



記憶體及邏輯代工利基市場中的重要地位

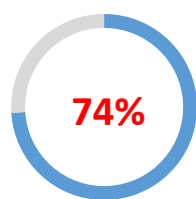
作為一家專業代工廠，我們擁有強大的影響力，在多個利基市場佔據主導地位，推動長期成長

記憶體代工廠 (DRAM and NAND)



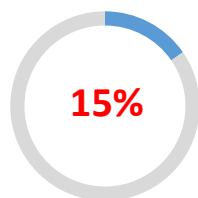
DRAM (≤1Gb)¹

適用於網路、監控、消費電子、PC、工業和汽車



Pseudo SRAM (≤256Mb)¹

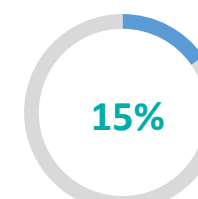
適用於功能手機、IoT 小工具和邊緣裝置



SLC NAND (1Gb~4Gb)¹

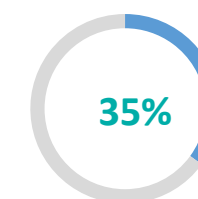
適用於網路、監控、消費電子、PC、工業和汽車

邏輯代工廠

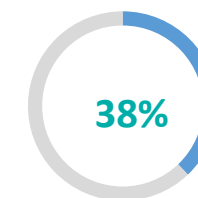


電源管理晶片

適用於智慧手機



射頻識別



觸控顯示驅動晶片

適用於平板電腦

% 市占率

資料來源：公司、Omdia, TrendForce

註：

1. 根據 TrendForce 及市場資訊，2025年晶片出貨量

2. 根據 Omdia 及 TrendForce，2024 年 IC單位出貨量

多樣化的產品線，應用範圍廣泛



針對多種長期成長的終端市場，滿足不同客戶的晶圓代工需求

Power management IC / power discrete	MCU / COMM	Display IC	Image sensor	DRAM	Flash	Emerging memory
- DC-DC and AC-DC Converter - BMS / PD - LED Driver - MOSFET - IGBT - GaN 	- Embedded flash - OTP, MTP - RF(SiGe), Bluetooth, WiFi - RFID, NFC 	- STN - a-Si TFT - OLED - e-paper / e-tag 	- CIS (FSI / BSI) - a-Si - FoD 	- Consumer DRAM - Niche DRAM ($\leq 4\text{Gb}$ DRAM) 	- SLC NAND Flash (1/2/4Gb) - NOR Flash ($\geq 64\text{Mb}$) 	- AIM - MRAM - Wafer-on-Wafer (in development) 
210 個代工平臺				56 個代工平臺		

Our pervasive technology platforms



White goods



Consumer electronics



Industrial electronics



Internet of Things



Automotive electronics



Security and others

Serving Global Leaders



獨特的技術與製程平台



在邏輯和記憶體IC生產中都擁有可觀產能，並具備產線靈活調度的能力，加上創新技術以及鋁、銅製程的均衡使用，我們以低成本解決方案競爭優勢吸納更多的新客戶。

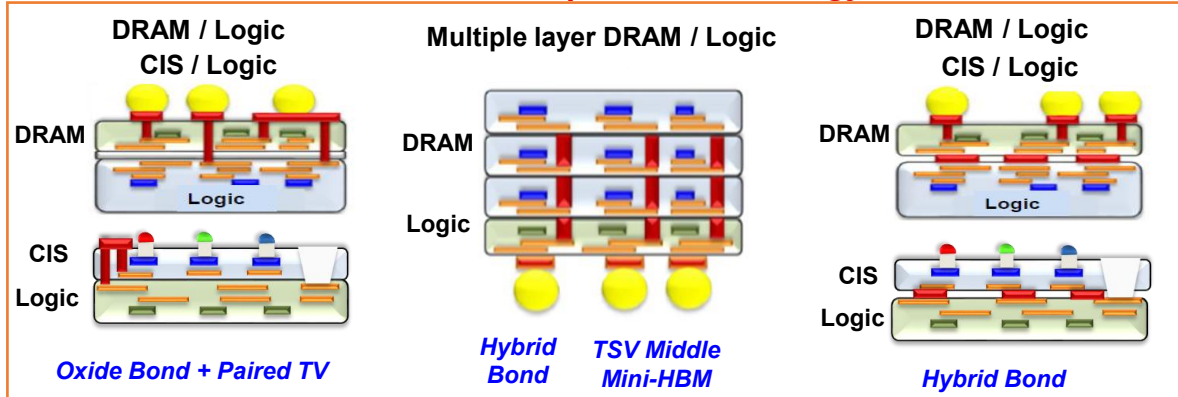
Example on innovative technology: 3D Interchip WoW¹ technology

Memory (low-power DRAM)



Logic

3D Interchip WoW Technology



Key applications



AI



IoT



High Performance Computing



CMOS Image Sensor applications



Low latency



High bandwidth data transmission



Low power consumption



Solid computing performance

Use of both aluminum and copper process



90%
of current production for 80nm
and above



Up to **30%** die cost reduction
for 12", as compared to 8"
for the same technology
node



Good customer
adherence from
130~80nm



New
Tongluo fab uses copper for 55nm and
below and 3D interchip

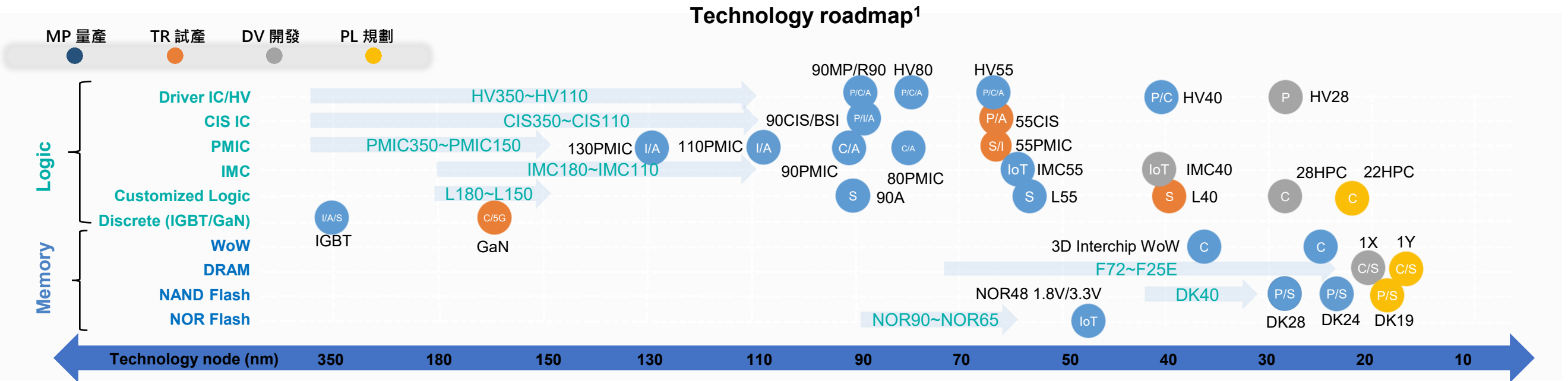


Meet customers' needs
of wider range of
product applications

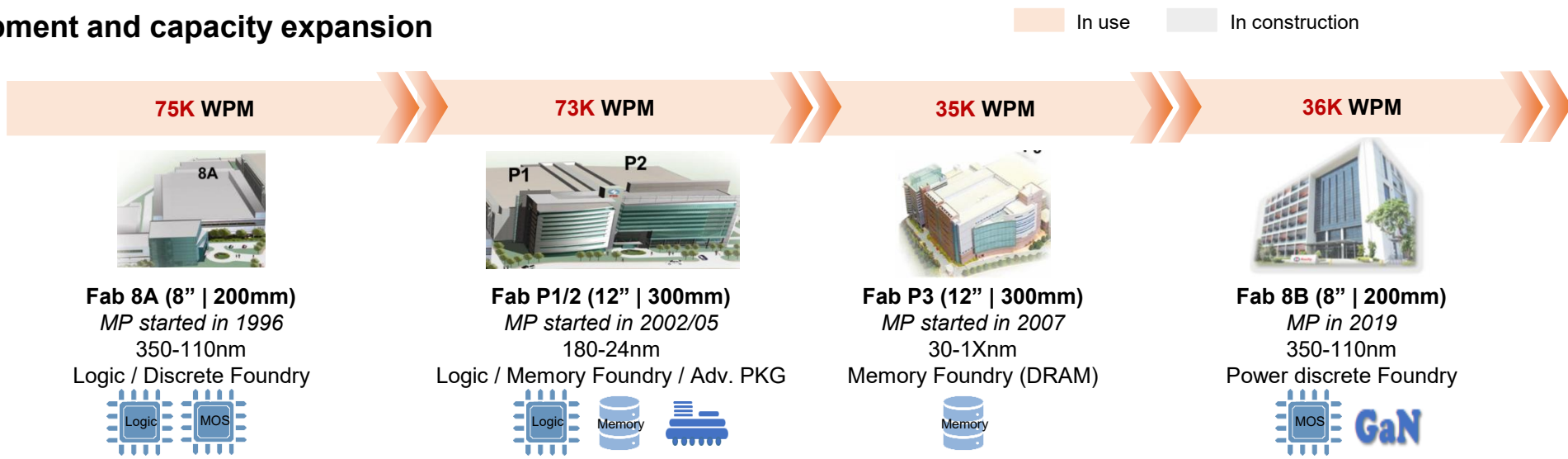
資料來源：公司

Note: (1) WoW represents Wafer-on-Wafer, a 3D wafer stacking process technology

清晰的技術發展脈絡搭配穩健的產能擴張計畫



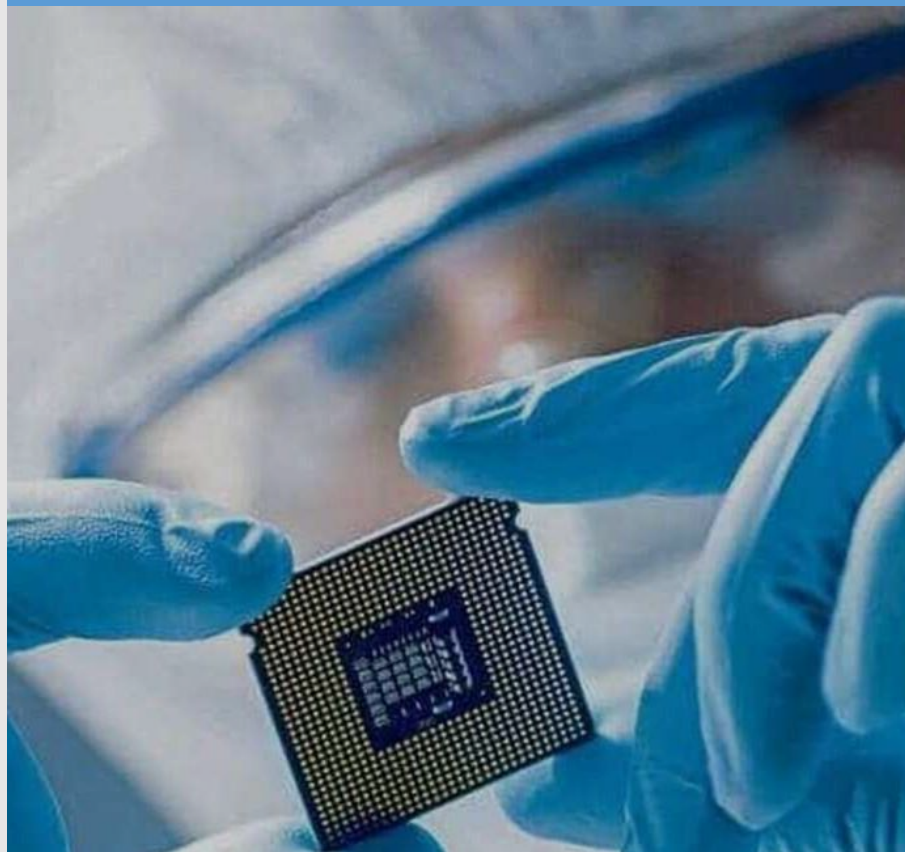
Fab development and capacity expansion



資料來源：公司

Notes:

(1) A= Auto, P= Phone, IoT= Internet of Things, C= Computer, S= Consumable, I= Industrial ; (2) MP= Mass Production, TR= Trial Run, DV= Development, and PL= Planning



第三部分

財務摘要

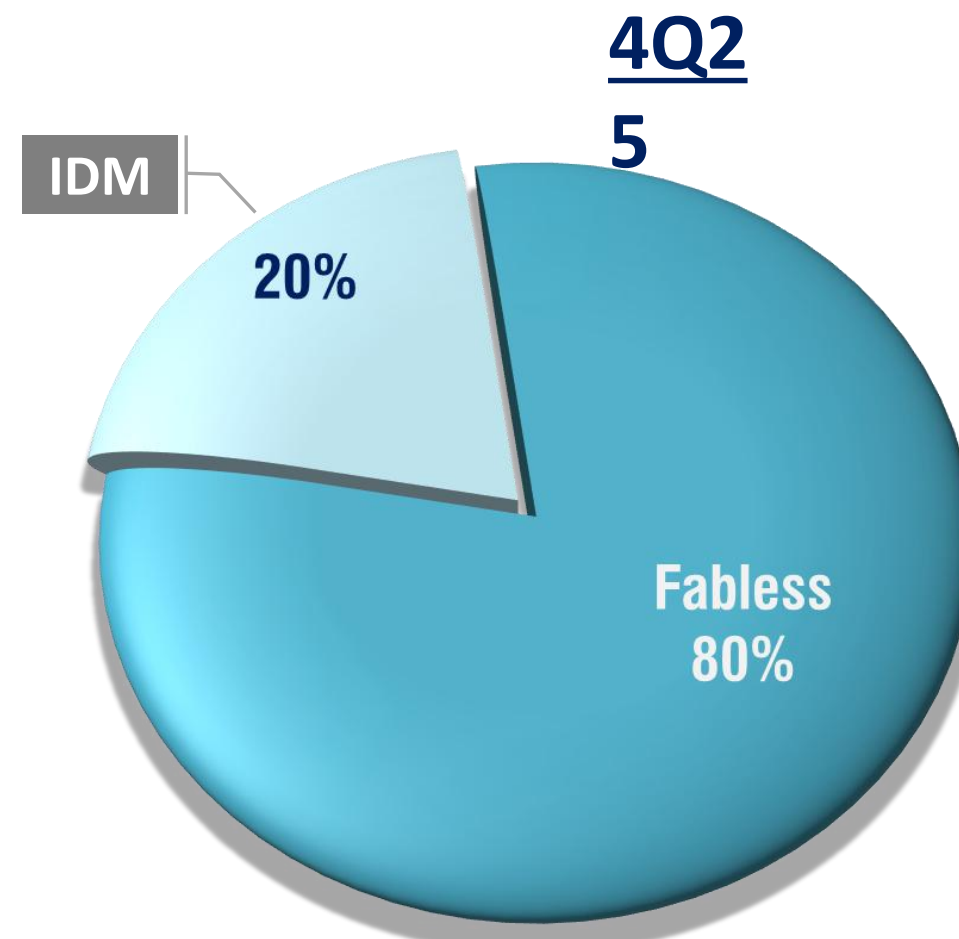
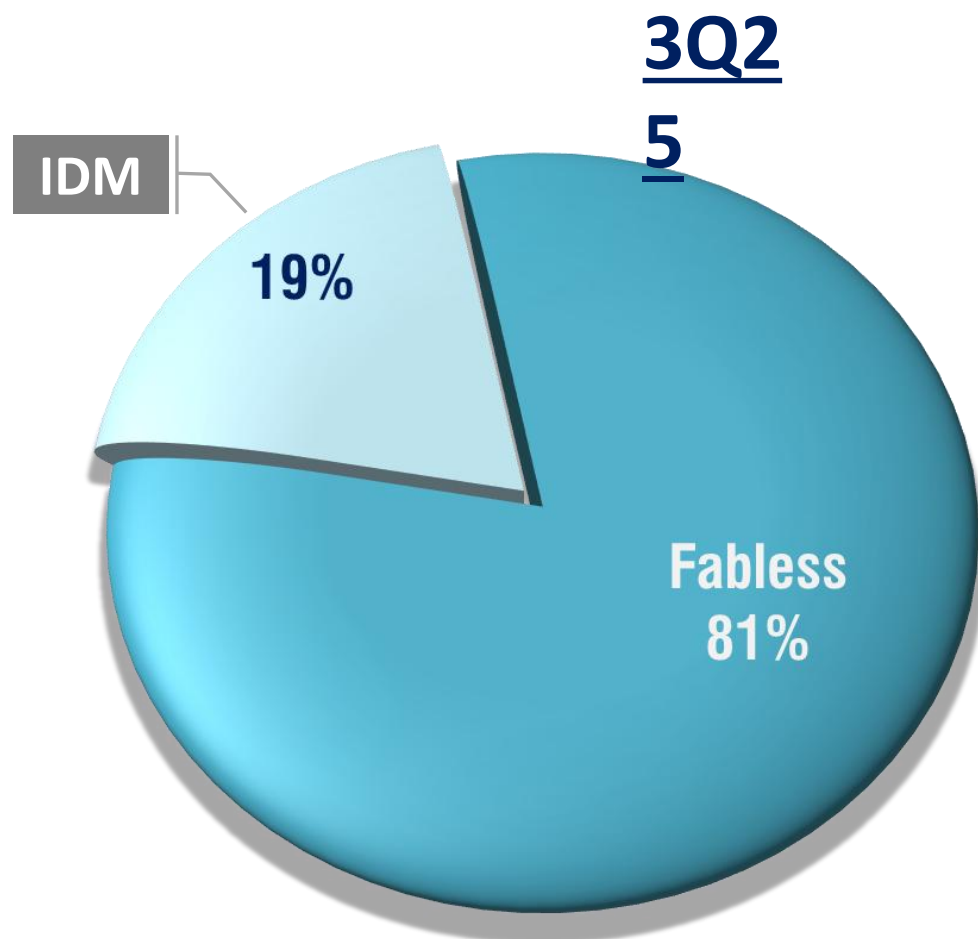
營運結果摘要



單位：新台幣 百萬元

	114年 第四季/12月 (自結數)	114年 第三季/9月	QoQ %	113年 第四季/12月	YoY %
營業收入	12,495	11,841	6	11,132	12
淨損	(654)	(2,728)	76	(1,501)	56
普通股每股虧損(元)	(0.16)	(0.65)	75	(0.36)	56
現金及約當現金	24,215	23,348	4	18,355	32
總資產	178,686	178,363	-	188,921	(5)
總負債	96,686	96,211	-	100,275	(4)
總權益	82,000	82,152	-	88,646	(7)
晶圓製造整合：					
出貨片數(仟片-約當12吋片數)	415	440	(6)	359	16
產能利用率(%)	82%	78%	5	71%	15

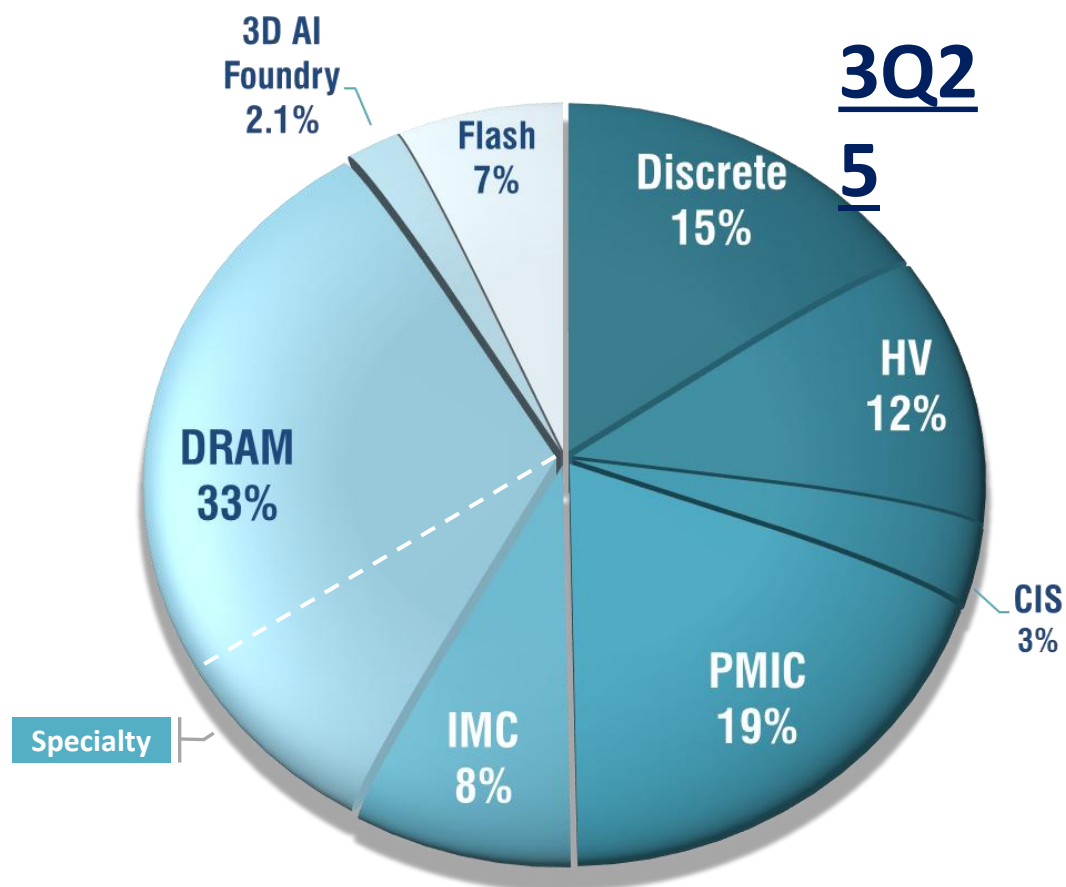
產品銷售組合分析-客戶別



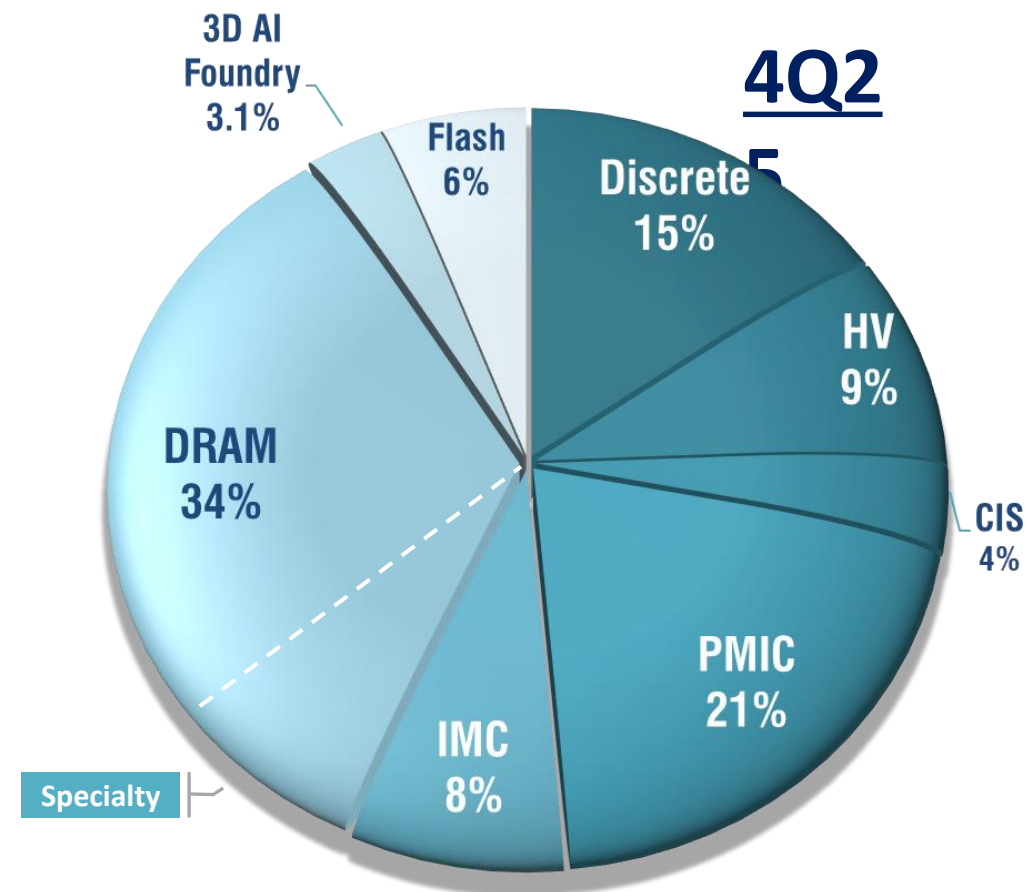
- IDM : 整合元件廠
- Fabless : 設計公司



產品銷售組合分析-產品別

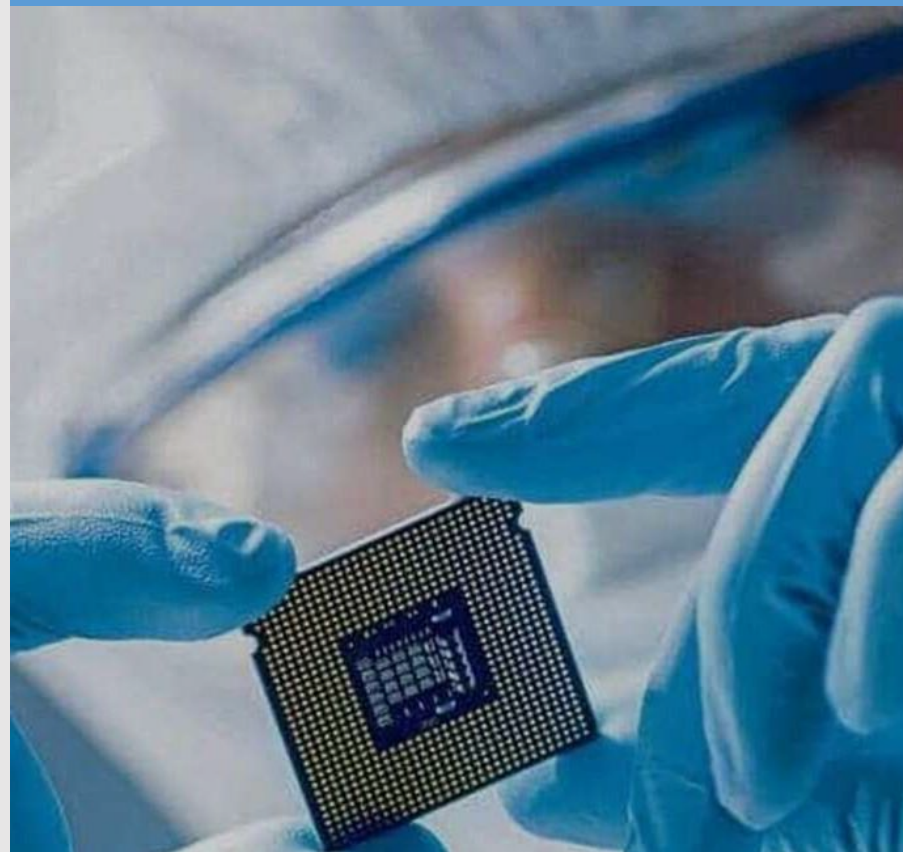


- **Discrete** : 分離式元件產品
- **HV** : 高壓邏輯驅動晶片
- **CIS** : 影像感測晶片
- **PMIC** : 電源管理晶片



- **IMC** : 嵌入式邏輯產品
- **Flash** : 快閃記憶體產品
- **DRAM** : 動態隨機存取記憶體產品(include Specialty)
- **3D AI Foundry**: Interposer/ WoW..etc

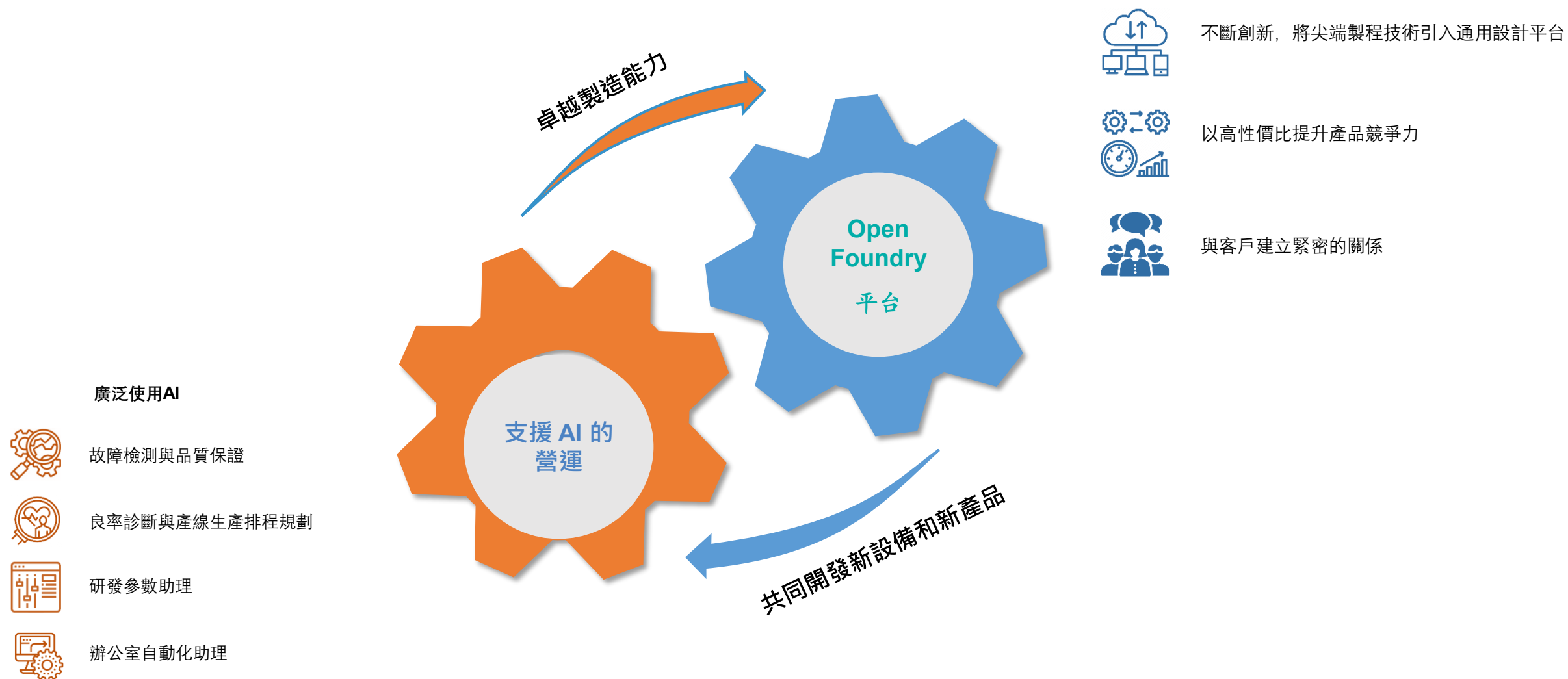




第四部分

成長策略

持續增強我們的Open Foundry平台



資料來源：公司

專注於具長期成長的終端應用，掌握新的市場機會



拓展新市場

- 拓展我們與日本、美國和歐洲客戶的客戶群，實現長期、多元化的產品出口市場
- 掌握供應鏈多元化趨勢



終端產品配置優化

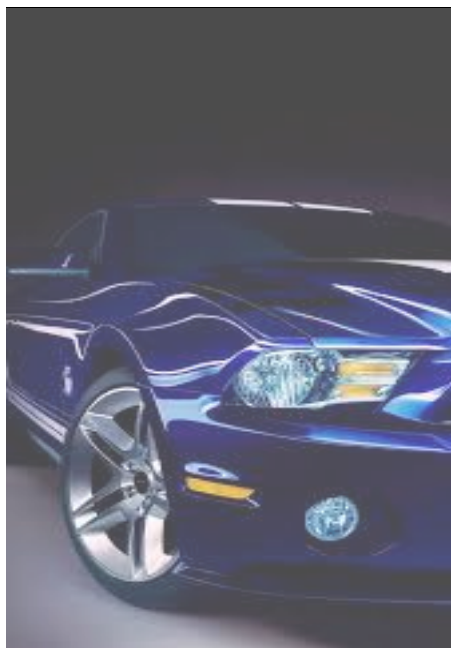
- 現有的8"和12"晶圓廠產能，為更多的汽車和工業客戶提供服務
- 新的12"晶圓廠產能以終端消費品為主，並逐步擴大AI、汽車和工業產品



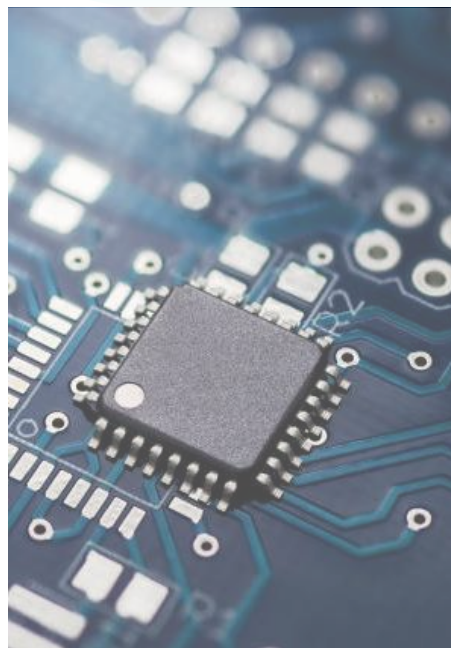
保持AIoT市佔率

- 將 DRAM 技術更新為 1xnm
- 融合互補的 NOR 和 SLC NAND 技術

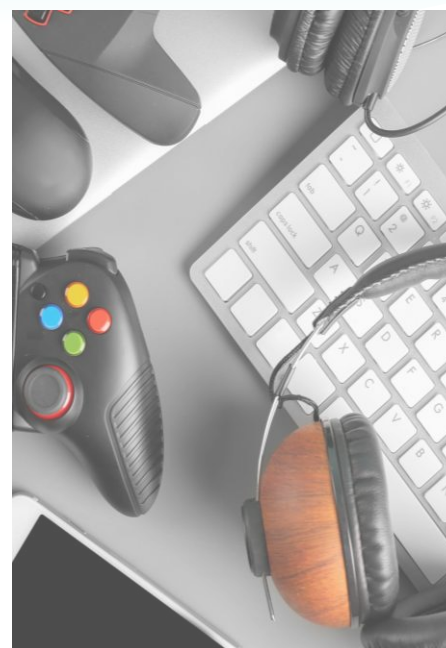
汽車/電子化



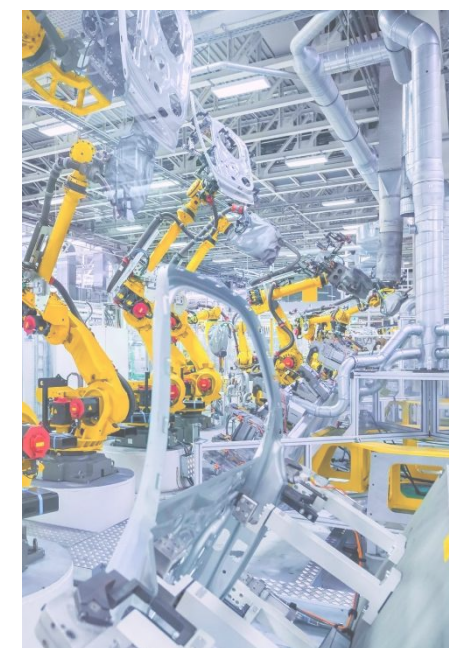
運算/AI



消費性電子產品



工業物聯網



謝謝!

發言人/副總：譚仲民
erictang@powerchip.com

